

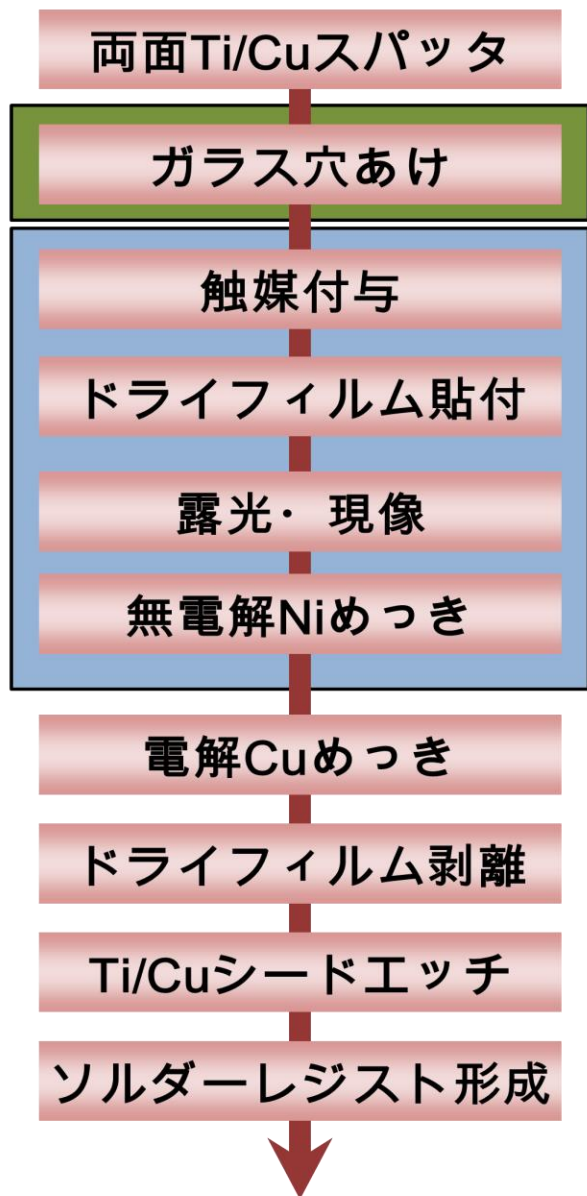
TGVプロセスの紹介

ウェットプロセスによるスルーホールめっき

【背景・目的】

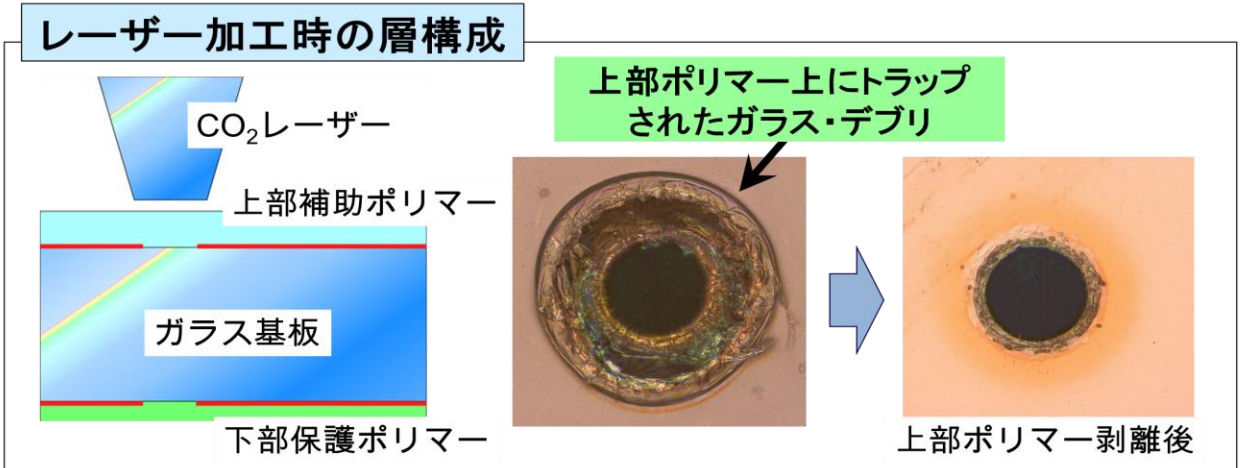
近年注目されているガラスインターポーターの要素技術である、ガラス基板へのスルーホール形成および配線形成プロセスの提供。

【プロセス】

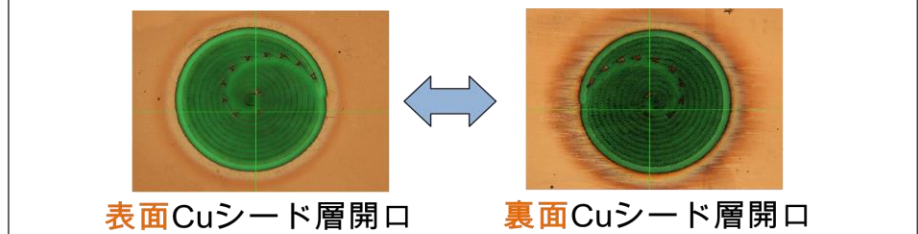


プロセスポイント①

- ・補助ポリマーによるガラスの排出補助とデブリ対策
- ・両面露光用アライメント形成手法



レーザー両面同時形成アライメントマーク



プロセスポイント②

- ・スパッタTi/Cuとガラスへ同時に触媒付与
- ・ドライフィルム開口部のみ無電解Niめっき析出
⇒無電解Niめっきのエッチング不要

【仕上がり】

